

2025-2031年中国半导体光 刻胶市场增长潜力与投资策略制定报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2025-2031年中国半导体光刻胶市场增长潜力与投资策略制定报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/report/16719891JU.html>

【报告价格】纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

【出版日期】2025-08-21

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明: 《2025-2031年中国半导体光刻胶市场增长潜力与投资策略制定报告》由权威行业研究机构博思数据精心编制,全面剖析了中国半导体光刻胶市场的行业现状、竞争格局、市场趋势及未来投资机会等多个维度。本报告旨在为投资者、企业决策者及行业分析师提供精准的市场洞察和投资建议,规避市场风险,全面掌握行业动态。

第1章 半导体光刻胶行业综述及数据来源说明

1.1 光刻胶行业界定

1.1.1 光刻胶的定义

1.1.2 光刻是半导体制造微图形工艺的核心,光刻胶是关键材料

1.1.3 光刻胶技术参数

1.1.4 光刻胶所处行业

1.1.5 按下游应用分类

1、半导体光刻胶

2、显示光刻胶

3、PCB光刻胶

4、其他

1.2 半导体光刻胶行业分类

1.3 本报告研究范围界定说明

1.4 光刻胶行业市场监管&标准体系

1.5 本报告数据来源及统计标准说明

1.5.1 本报告权威数据来源

1.5.2 本报告研究方法及统计标准说明

第2章 全球半导体光刻胶行业发展现状及趋势洞察

2.1 全球光刻胶行业发展历程

2.1.1 萌芽期

2.1.2 初步发展期

2.1.3 快速发展期

2.2 全球光刻胶技术进展及产品研发进度

2.2.1 全球半导体光刻胶技术进展情况

2.2.2 全球半导体光刻胶厂商产品研发进度

2.3 全球半导体光刻胶行业发展现状分析

2.3.1 全球半导体光刻胶工厂分布

2.3.2 全球半导体光刻胶量产进度

2.3.3 全球半导体光刻胶细分市场

2.3.4 全球半导体产业发展现状及光刻胶需求分析

2.4 全球半导体光刻胶行业市场竞争状态及格局分析

2.5 全球半导体光刻胶行业市场规模体量及前景预判

2.5.1 全球半导体光刻胶行业市场规模体量

2.5.2 全球半导体光刻胶行业市场趋势分析

2.5.3 全球半导体光刻胶行业发展趋势洞悉

2.6 全球半导体光刻胶行业发展经验总结和有益借鉴

第3章 中国半导体光刻胶行业发展现状及市场痛点

3.1 中国半导体光刻胶行业发展历程

3.2 中国半导体光刻胶行业技术进展

3.2.1 半导体光刻胶行业科研投入

3.2.2 半导体光刻胶行业科研创新

3.2.3 半导体光刻胶行业关键技术

3.2.4 半导体光刻胶制备过程

3.3 中国半导体光刻胶行业对外贸易状况

3.3.1 海关总署——半导体光刻胶归类

3.3.2 中国光刻胶进出口贸易概况

3.3.3 中国光刻胶进口贸易状况

1、光刻胶行业进口贸易规模

2、光刻胶行业进口价格水平

3、光刻胶行业进口产品结构

3.3.4 中国光刻胶出口贸易状况

1、光刻胶行业出口贸易规模

2、光刻胶行业出口价格水平

3、光刻胶行业出口产品结构

3.3.5 中国光刻胶行业进出口贸易影响因素及发展趋势

3.4 中国半导体光刻胶行业市场主体

3.5 中国半导体光刻胶行业市场供给分析

3.6 中国半导体光刻胶行业市场需求分析

3.6.1 半导体光刻胶需求量(万吨)

3.6.2 半导体光刻胶行业自给率

3.6.3 半导体光刻胶市场行情走势

3.7 中国半导体光刻胶行业市场规模体量

3.7.1 中国光刻胶行业市场规模体量

3.7.2 半导体光刻胶行业市场规模体量

3.8 中国半导体光刻胶行业市场竞争格局

3.9 中国半导体光刻胶国产替代布局现状

3.9.1 中国半导体光刻胶国产替代必然性分析

1、半导体光刻胶处于各行业产业链上游,具有举足轻重的地位

2、半导体材料国产化的必然趋势

3、光刻胶国产代替是中国半导体产业的迫切需

要3.9.2 中国半导体光刻胶国产替代现状3.9.3 中国半导体光刻胶国产替代趋势3.10 中国半导体光刻胶行业市场发展痛点第4章半导体光刻胶产业链全景及配套产业发展4.1 半导体光刻胶产业链结构梳理4.2 半导体光刻胶产业链生态图谱4.3 半导体光刻胶产业链区域热力图4.4 半导体光刻胶行业成本投入结构4.4.1 光刻胶在半导体成本中的比重4.4.2 光刻胶原材料构成及主要作用4.4.3 半导体制造材料成本结构4.4.4 日本和美国主导全球光刻胶原材料市场4.5 光刻胶原材料：光刻胶单体及树脂4.5.1 光刻胶用树脂类型及特征4.5.2 光刻胶单体概述4.5.3 树脂市场供应情况1、产品供应情况2、产品供应商情况3、产品价格情况4.5.4 光刻胶用树脂发展趋势4.6 光刻胶原材料：光敏材料4.6.1 光刻胶用光敏材料概述1、光引发剂2、光致产酸剂——光酸（PAG）4.6.2 光引发剂市场供应情况1、产品供应情况2、产品供应商情况3、产品价格情况4.6.3 光刻胶用光引发剂发展趋势4.7 光刻胶原材料：溶剂4.7.1 光刻胶用溶剂概述4.7.2 溶剂市场供应情况1、产能建设及产品应用情况2、产品供应情况3、产品供应商情况4、产品价格情况4.7.3 光刻胶用溶剂发展趋势4.8 光刻胶原材料：其他助剂4.9 配套产业布局对半导体光刻胶行业的影响总结第5章中国半导体光刻胶行业细分产品市场分析5.1 中国半导体光刻胶行业细分市场概况5.1.1 中国半导体光刻胶行业细分市场对比5.1.2 中国半导体光刻胶行业细分市场结构5.2 半导体光刻胶细分市场：G线光刻胶5.2.1 G线光刻胶概述5.2.2 G线光刻胶市场简析5.3 半导体光刻胶细分市场：I线光刻胶5.3.1 I线光刻胶概述5.3.2 I线光刻胶市场简析5.4 半导体光刻胶细分市场：KrF光刻胶5.4.1 KrF光刻胶概述5.4.2 KrF光刻胶市场简析5.5 半导体光刻胶细分市场：ArF光刻胶5.5.1 ArF光刻胶概述5.5.2 ArF光刻胶市场简析5.6 半导体光刻胶细分市场：EUV光刻胶5.6.1 EUV光刻胶概述5.6.2 EUV光刻胶市场简析5.7 中国半导体光刻胶行业细分市场影响因素及发展趋势5.7.1 半导体光刻胶细分市场影响因素5.7.2 半导体光刻胶细分市场发展趋势5.8 中国半导体光刻胶行业细分市场战略地位分析第6章中国半导体光刻胶行业细分应用市场分析6.1 半导体产业市场现状6.1.1 全球半导体产业向中国大陆转移6.1.2 中国半导体产业市场规模6.1.3 中国半导体产业细分市场6.1.4 中国集成电路市场规模6.1.5 中国集成电路市场结构6.2 中国半导体产业趋势前景6.2.1 中国半导体产业趋势分析6.2.2 中国半导体产业发展趋势6.3 半导体光刻胶细分应用领域分布6.4 半导体光刻胶细分应用：逻辑IC6.4.1 逻辑IC领域半导体光刻胶应用概述6.4.2 逻辑IC市场现状及发展趋势1、逻辑IC市场现状2、逻辑IC发展趋势6.4.3 逻辑IC领域半导体光刻胶应用市场现状6.4.4 逻辑IC领域半导体光刻胶应用市场潜力6.5 半导体光刻胶细分应用：动态随机存取存储器（DRAM）6.5.1 动态随机存取存储器（DRAM）领域半导体光刻胶应用概述6.5.2 动态随机存取存储器（DRAM）市场现状及发展趋势1、动态随机存取存储器（DRAM）市场现状2、动态随机存取存储器（DRAM）发展趋势6.5.3 动态随机存取存储器（DRAM）领域半导体光刻胶应用市场现状6.5.4 动态随机存取存储器（DRAM）领域半导体光刻胶应用市场潜力6.6 半导体光刻胶细分应用：NVM（非易失性内存）6.6.1 NVM（非易失性内存）领

域半导体光刻胶应用概述6.6.2 NVM（非易失性内存）市场现状及发展趋势1、NVM（非易失性内存）市场现状2、NVM（非易失性内存）发展趋势6.6.3 NVM（非易失性内存）领域半导体光刻胶应用市场现状6.6.4 NVM（非易失性内存）领域半导体光刻胶应用市场潜力6.7 中国半导体光刻胶行业细分应用市场战略地位分析第7章全球及中国半导体光刻胶企业布局案例解析7.1 全球及中国半导体光刻胶主要企业布局梳理7.2 全球半导体光刻胶主要企业布局案例分析7.2.1 日本合成橡胶（JSR）1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.2.2 日本信越化学1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.2.3 日本东京应化（TOK）1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.2.4 美国杜邦1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.2.5 日本富士胶片1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.3 中国半导体光刻胶主要企业布局案例分析7.3.1 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.3.2 晶瑞电子材料股份有限公司1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.3.3 深圳市容大感光科技股份有限公司1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.3.4 江苏南大光电材料股份有限公司1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.3.5 上海新阳半导体材料股份有限公司1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.3.6 彤程新材料集团股份有限公司1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.3.7 厦门恒坤新材料科技股份有限公司1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.3.8 上海飞凯材料科技股份有限公司1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.3.9 北京欣奕华科技有限公司1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战略分析7.3.10 北京科华微电子材料有限公司1、企业发展基本情况2、企业主要产品分析3、企业经营状况分析4、企业发展战略分析第8章中国半导体光刻胶行业发展环境洞察&SWOT分析8.1 中国半导体光刻胶行业经济（Economy）环境分析8.1.1 中国宏观经济发展现状8.1.2 中国宏观经济发展展望8.1.3 中国半导体光刻胶行业发展与宏观经济相关性分析8.2 中国半导体光刻胶行业社会（Society）环境分析8.2.1 中国半导体光刻胶行业社会环境分析8.2.2 社会环境对半导体光刻胶行业发展的影响总结8.3 中国半导体光刻胶行业政策（Policy）环境分析8.3.1 国家层面半导体光刻胶行业政策规划汇总及解读1、国家层面半导体光刻胶行业政策汇总及解读2、国家层面半导体光刻胶行业规划汇总及解读8.3.2 31省市半导体光刻胶行业政策规划汇总及解读1、31省市半导体光刻胶行业政策规划汇总2、31省

市半导体光刻胶行业发展目标解读8.3.3 国家重点规划/政策对半导体光刻胶行业发展的影响8.3.4 政策环境对半导体光刻胶行业发展的影响总结8.4 中国半导体光刻胶行业SWOT分析

第9章中国半导体光刻胶行业市场前景及发展趋势分析9.1 中国半导体光刻胶行业发展潜力评估9.2 中国半导体光刻胶行业未来关键增长点分析9.3 中国半导体光刻胶行业趋势预测分析9.4 中国半导体光刻胶行业发展趋势预判9.4.1 中国半导体光刻胶行业市场竞争趋势9.4.2 中国半导体光刻胶行业技术创新趋势9.4.3 中国半导体光刻胶行业细分市场趋势1、EUV光刻胶的比重将会提升2、ArF光刻胶国产替代有望加快第10章中国半导体光刻胶行业投资规划建议规划策略及建议10.1 中国半导体光刻胶行业进入与退出壁垒10.1.1 半导体光刻胶行业进入壁垒分析1、技术壁垒2、客户认证壁垒3、设备壁垒4、原材料壁垒5、资金壁垒6、资质壁垒10.1.2 半导体光刻胶行业退出壁垒分析10.2 中国半导体光刻胶行业投资前景预警10.3 中国半导体光刻胶行业投资机会分析10.3.1 半导体光刻胶产业链薄弱环节投资机会10.3.2 半导体光刻胶行业细分领域投资机会10.3.3 半导体光刻胶行业区域市场投资机会10.3.4 半导体光刻胶产业空白点投资机会10.4 中国半导体光刻胶行业投资价值评估10.5 中国半导体光刻胶行业投资前景研究与建议

图表目录

图表1：光刻胶的定义

图表2：一种NMOS三极管集成电路结构的制造过程

图表3：半导体光刻胶涂抹方法

图表4：光刻胶主要技术参数

图表5：本报告研究领域所处行业

图表6：光刻胶行业所属的国民经济分类

图表7：光刻胶专业术语

图表8：光刻胶概念辨析

图表9：光刻胶按下游应用分类

图表10：半导体光刻胶产品分类及特征

图表11：半导体光刻胶行业分类图

图表12：本报告研究范围界定

图表13：光刻胶行业监管体系及机构介绍

图表14：GB/T 16527-2024年（硬面感光板中光致抗蚀剂和电子束抗蚀剂）基本内容

图表15：晶瑞电材光刻胶企业标准汇总

图表16：Q/320506 ZRH47-2020（I线正性光刻胶）部分产品标准内容

图表17：本报告权威数据资料来源汇总

图表18：本报告的主要研究方法及统计标准说明

图表19：全球光刻胶行业在萌芽期的重要事件

图表20：全球光刻胶行业在初步发展期的重要事件

图表21：全球光刻胶行业在快速发展期的重要事件

图表22：全球半导体光刻胶技术进展情况

图表23：全球半导体光刻胶厂商产品研发进度情况

图表24：全球半导体光刻胶工厂分布情况

图表25：全球半导体光刻胶行业主要企业生产进度

图表26：全球半导体光刻胶行业细分产品应用占比（单位：%）

图表27：全球光刻胶应用结构（单位：%）

图表28：全球光刻胶行业主要兼并、重组事件

图表29：全球光刻胶行业的竞争梯队（按市场份额）

图表30：全球光刻胶行业市场份额（单位：%）更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.bosidata.com/report/16719891JU.html>